

Trento, 29 giugno 2018

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'appalto di fornitura di attrezzature scientifiche per il potenziamento della Micro Nano Facility della Fondazione Bruno Kessler verso la nanofabbricazione d'avanguardia.

Nota di chiarimento n. 7

A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 1

Lotto 1: Capitolato Tecnico - punto 2.1 Tabella 1 Ricette # 4 e # 5.

Domanda: Vi preghiamo di specificare quale maschera per questa ricetta, che non abbiamo trovato specificata.

Risposta

Nella tabella 1 sono indicate le prestazioni minime richieste. Per le ricette #1 e #3-#6 i parametri Etch Rate, WLU e LLU e sidewall sono richiesti con la mask1; come indicato nella legenda sotto la tabella: "*Mask 1 e Mask 2 come in allegato 5 "CrossSectionMaschereMappature"*".

Quesito 2

Lotto 1: Allegato 5 -CSA Ricette # 4 e # 5.

Domanda: Vi preghiamo di specificare quale maschera per questa ricetta, che non abbiamo trovato specificata.

Risposta

Come dichiarato nel Capitolato Tecnico al punto 2.1 Tabella 1 e Allegato 5 -CSA al punto 2.3 - Formule per le ricette #1 e #3-#6 si utilizza la mask 1 descritta nello stesso Allegato 5 -CSA.

Quesito 3

Lotto 1: Tabella 1 del Capitolato tecnico. Nota 1: Sidewall misurato su strutture circolari da 2 um di diametro

Domanda: Tenendo conto degli effetti del clivaggio per realizzare misure in cross-section, è possibile utilizzare per la misura anche strutture tipo "trenches"?

Risposta

E' preferibile utilizzare strutture circolari perché per queste il profilo del fotoresist è in genere verticale, mentre per i trenches è possibile che sia più inclinato.

Quesito 4

Lotto 1: Tabella 1 Ricetta # 3: Poly etch con chimica base Cloro

Domanda: Pur mantenendo quanto richiesto al punto 2.1-2, è possibile utilizzare un gas aggiuntivo, tra quelli disponibili al punto 2.2.5, oltre al Cloro?

Risposta

Sì, è possibile utilizzare un gas aggiuntivo purché sia nella lista citata (punto 2.2.5 del capitolato tecnico).

Quesito 5

Lotto 3: Relativamente al Capitolato Tecnico punto 2.2.4

Movimentazione di substrati di materiali e spessori diversi.

Domanda: Prego chiarire se i substrati sono trasparenti, semitrasparenti o opachi.

Risposta

I substrati possono essere trasparenti, semitrasparenti ed opachi, l'importante è che la macchina possa lavorare con substrati di silicio, SiC, quarzo, pyrex come descritto dal Capitolato Tecnico.

- Paola Angeli -

Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente

Responsabile Servizio Appalti e Contratti

(firmato in originale)

Documento pubblicato sul sito <https://trasparenza.fbk.eu> in data 29 giugno 2018